

**BST-21503A 150g Pasta di saldatura di qualità superiore per il LED BGA SMD PGA Top Sale Saldatore Paste  
Flux Grease**

**Descrizione del prodotto:**

100% brandnew ed alta qualità !!

Il flusso di rosin è utilizzato per facilitare la saldatura.

Pulisce e previene l'ossidazione del metallo che consente alla saldatura di creare legami meccanici ed elettrici forti e duraturi.

Funziona anche come agente umidificante, aumentando il flusso di saldatura e l'efficienza del processo di saldatura.

Perfetta per telefoni cellulari, schede PC e altre sofisticate saldature a flusso elettronico a chip.

**specifiche tecniche:**

Prodotto: BST-21503A

Punto di fusione: 60 °C

Peso: 150g / pc

PRODUCT DISPLAY

---



## PRODUCT DETAILS



Name: Soldering Paste

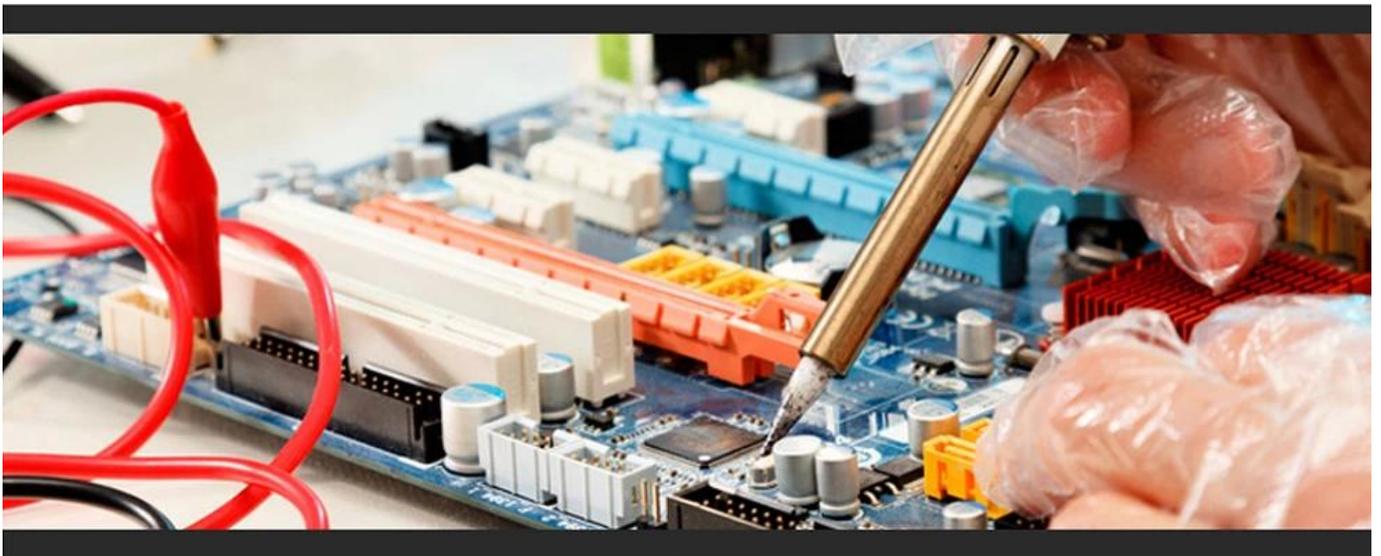
Size:  $\Phi 80 \times 45$ mm

Composition: Solder powder, resin

Model: BST-21503A

Weight: 100g

Melting point:  $60^{\circ}\text{C}$





- ▲ Stable performance, Not volatile, long life cycle, the amount of province;
- ▲ Non-toxic non-irritating odor, the use of safe and reliable;
- ▲ The IC and PCB are not corrosive
- ▲ Its boiling point is only slightly higher than the melting point of solder.

**Features:** Solder melting at the time of soldering begins to boil endothermic vaporization, which can be maintained at this temperature using IC and PCB temperatures. In the demolition of the chip with a lot of solder paste, it melts fast, you can flow to the BGA chip below. Rosin is solid without solder paste convenient.

PRODUCT PHOTOGRAPH



